8 键接触板检测 IC

(8 KEYS TOUCH PAD DETECTOR IC)

概述

TH288 是一款接触板检测(touch pad detector) IC,提供8个接触键。接触检测 IC 有意取代传统固定pad尺寸的直接按钮键。低功耗和宽工作电压是接触键在DC或AC应用中的特点。

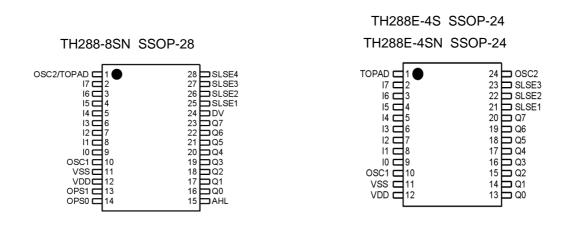
特点

- 工作电压 2.5V~5.25V
- 工作电流在VDD=3V时典型值80uA, 最大值160uA
- 输出刷新率在VDD=3V时约55Hz
- 16 阶可选灵敏度 (SLSE1~4管脚选项)
- 稳定的人体接触检测,以取代传统直接切换的键(direct switch key)
- 提供直接(direct)模式、矩阵(matrix)模式和串行(serial)模式,由pad选项选择
- 直接模式下最多8个输入pad和8个输出; 串行接口模式下最多8个输入pad; 固定的2*4和3*3矩阵类型提供最多8个输入pads
- 输出可由pad选项选择为高电平有效或低电平有效
- 在上电之后有0.5~1秒的稳定时间,在此期间不要触摸键区(key-pad),且功能无效

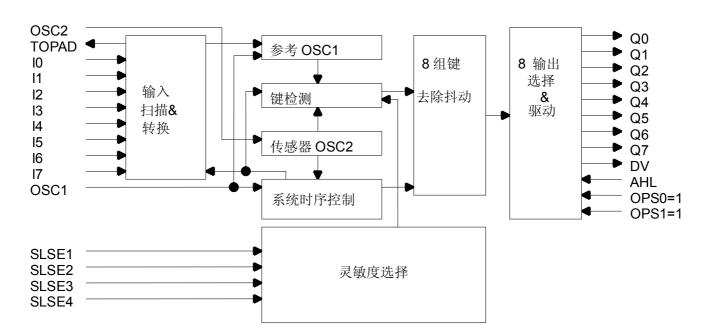
应用

- 广泛的消费性产品
- 防水电器
- 取代按钮键

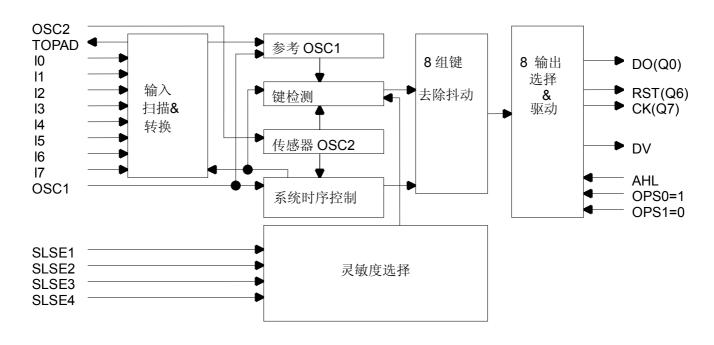
封装结构



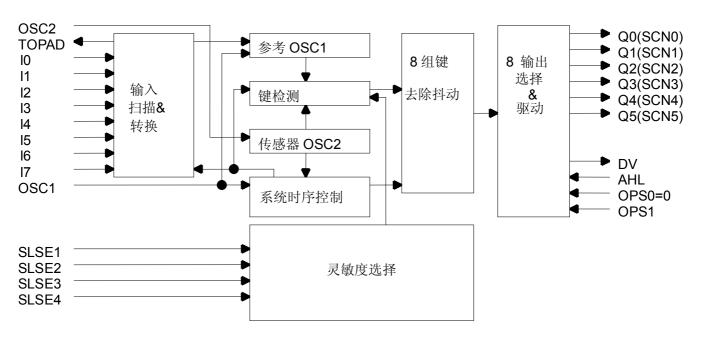
直接(DIRECT)模式框图:



串行接口(SERIAL INTERFACE)模式框图:



键矩阵(KEY-MATRIX)模式框图: (3*3 或 2*4)



管脚描述 以TH288-8SN 为例

管脚号	管脚名称	共用管脚	I/O 类型	管脚描述
1	OSC2		I/O	传感器振荡器
	TOPAD		I	此为输入口内部公共点(common point)
2	I7		I	输入口
3	I6		I	输入口
4	I5		I	输入口
5	I4		I	输入口
6	I3		I	输入口
7	I2		I	输入口
8	I1		I	输入口
9	10		I	输入口
10	OSC1		I/O	系统振荡器管脚
11	VSS		P	负电源电压,接地
12	VDD		P	正电源电压
13	OPS1		I-PH	输出类型选项管脚
14	OPS0		I-PH	输出类型选项管脚
15	AHL		I-PH	选择输出为高电平有效或低电平有效
				Q0 为直接模式下的输出管脚
16	Q0	(DO/SCN0)	I/O	DO 为串行模式下的移位数据输出
				SCN0 为矩阵模式下的第一个扫描(scanning)管脚
1.7	0.1	(0.00.11)	1/0	Q1 为直接模式下的输出管脚
17	Q1	(SCN1)	I/O	SCN1 为矩阵模式下的第二个扫描(scanning)管脚
18	02	(SCN2)	I/O	Q2 为直接模式下的输出管脚
10	Q2	(SCN2)	1/0	SCN2 为矩阵模式下的第三个扫描(scanning)管脚
19	Q3	(SCN3)	I/O	Q3 为直接模式下的输出管脚
17	٧٥	(50113)	1/ 0	SCN3 为矩阵模式下的第四个扫描(scanning)管脚
20	Q4	(SCN4)	I/O	Q4 为直接模式下的输出管脚
20	<u> </u>	(50114)	1/0	SCN4 为矩阵模式下的第五个扫描(scanning)管脚
21	Q5	(SCN5)	I/O	Q5 为直接模式下的输出管脚
21	——————————————————————————————————————	(86113)	1/ 0	SCN5 为矩阵模式下的第六个扫描(scanning)管脚
22	Q6	(RST)	I/O	Q6 为直接模式下的输出管脚
		(1651)	1, 0	RST 为串行模式下的复位输入管脚
23	Q7	(CK)	I/O	Q7 为直接模式下的输出管脚
23	Q/	(CK)	1/0	CK 为串行模式下的时钟输入管脚
24	DV		O	(表示) 数据有效的输出信号
25	SLSE1		I-PH	SLSE1~4 均为选择灵敏度的选项管脚
26	SLSE2		I-PH	SLSE1~4 均为选择灵敏度的选项管脚
27	SLSE3		I-PH	SLSE1~4 均为选择灵敏度的选项管脚
28	SLSE4		I-PH	SLSE1~4 均为选择灵敏度的选项管脚
说明:	> CK 和	RST 输入带	保护电阻,	为避免输出冲突。

08'/03/24 Page 4 of 14 Ver :1.2

电气特性

• 最大绝对额定值

参数	符号	条件	值	单位
工作温度	T_{OP}		-20 ~ +70	$^{\circ}$
存储温度	T_{STG}		- 50 ∼ +125	$^{\circ}\!\mathbb{C}$
电源电压	VDD	Ta=25°C	VSS-0.3 ~ VSS+5.5	V
输入电压	V_{IN}	Ta=25°C	VSS-0.3 ~ VDD+0.3	V
人体模式 (Human Body	ESD		>5	KV
Mode)				
注: VSS 代表系统接地端	j			

• DC/AC 特性: (测试条件为室内温度=25℃)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
			值	值	值	
工作电压	VDD		2.0	3	5.5	V
参考振荡器	OSC1	VDD=3V	-	440K	-	Hz
传感器振荡器	OSC2	VDD=3V 无负载	-	440K	1	Hz
工作电流	I _{OP}	VDD=3V 输出无负载	-	80	160	uA
输入口	V_{IL}	输入低电压	0	-	0.2	VDD
输入口	V_{IH}	输入高电压	0.8	-	1.0	VDD
输出口灌电流(Sink Current)	I_{OL}	VDD=3V, Vol=0.6V	-	8	-	mA
输出口拉电流(Source	I_{OH}	VDD=3V, Voh=2.4V	-	-4	-	mA
Current)						

功能描述

1.系统时序控制

▶ 为输入检测灵敏度保留了 4个管脚选项 16 阶

性能	特性	举例
系统时钟	OSC1	440KHz 在3V时
输出刷新率	<= OSC1/1024/8	~55Hz
DV 有效脉冲宽度	<= OSC1/8	~55KHz

2. 系统初始信号

系统初始或者模式初始				
状态	功能			
上电复位	系统复位至初始状态			
RST=1	串行模式移位计数器复位			

3. 中断

对于 MCU 系统,中断请求有益于软件编程。DV 信号提供了考虑周到的输出控制。DV 可为高电平有效或低电平有效,由 AHL 管脚选择。任何能通过去除抖动(de-bounce)过程的有效输入都将激活 DV 信号。

对于不同的应用,有些输出需要高电平有效而有些需要低电平有效。AHL管脚提供了可选择的性能。

AHL 管脚选项	输出有效状态
	去除抖动的 Ii 触发 Qi
AHL=0	DV=0
	Qi=0
	去除抖动的 Ii 触发 Qi
AHL=1	DV=1
	Qi=1

AHL	输入的 Ii	输出的 Qi 或 DV
0	非有效	1
	有效	0
1	非有效	0
	有效	1

4. 输出模式

大多数输出模式工作在直接(direct)或串行(serial)模式。只有当OPS0=0时,输出模式会为矩阵(matrix)类型。

	输出类型选项				
OPS1	OPS0	输出类型 备注			
1	1	直接(Direct)类型	Qi ← 去除抖动的 Ii		
0	1	串行(Serial)类型	使用 CK & RST & DO 串行输出去除抖动的键		
1	0	矩阵(Matrix)类型	固定的 3*3 矩阵类型		
0	0	矩阵(Matrix)类型	固定的 2*4 矩阵类型		

a. 直接模式: OPS1=1 & OPS0=1

直接模式	输出状态
输入触发	去除抖动的 Ii 触发 Qi

b. 键矩阵模式: OPS1=X & OPS0=0

b-1: 2*4 键映射 (OPS1=0 时)

矩阵	SCN2	SCN3	SCN4	SCN5
SCN0	10	I2	I4	I6
SCN1	I1	I3	I 5	I7

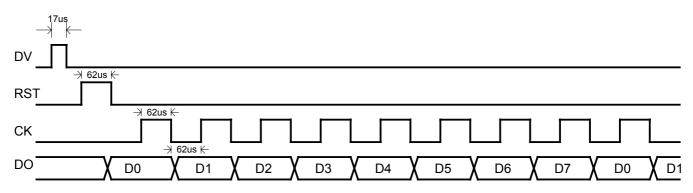
b-2: 3*3 键映射 (OPS1=1 时)

-		.,		
	矩阵	SCN3	SCN4	SCN5
	SCN0	10	I3	I6
	SCN1	I1	I 4	I7
	SCN2	I2	I5	-

c. 串行模式: OPS1=0 & OPS0=1

串行模式过程 (OPS1=0)				
复位 & 时钟	移位计数器	DO		
RST =1	0	去除抖动的 I0		
1 st CK	1	去除抖动的 I1		
2 nd CK	2	去除抖动的 I2		
3 rd CK	3	去除抖动的 I3		
4 th CK	4	去除抖动的 I4		
5 th CK	5	去除抖动的 I5		
6 th CK	6	去除抖动的 I6		
7 th CK	7	去除抖动的 I7		
8 th CK	0	去除抖动的 I0		
9 th CK	1	去除抖动的 I1		

串行模式 RST、CK 和 DO 的时序 (图中为最小值)



5. 选项管脚(Option pin)

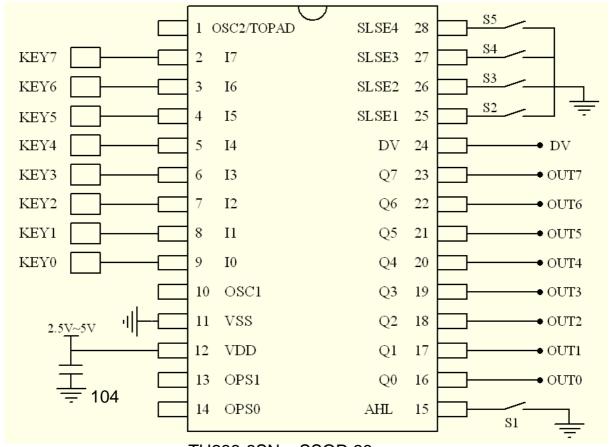
出于对省电和封装焊接选项的考虑,所有性能选项管脚都为锁存(latch)类型,在上电时初始化为 1。如果这些管脚被强制接到(forced to) VSS,状态将改变为 0,此过程中没有电流泄漏,不与省电策略冲突。

性能选项管脚	上电初始状态
OPS1	1
OPS0	1
AHL	1
SLSE0~SLSE5 灵敏度	111111

应用电路

a. 直接模式

直接键输出模式的应用

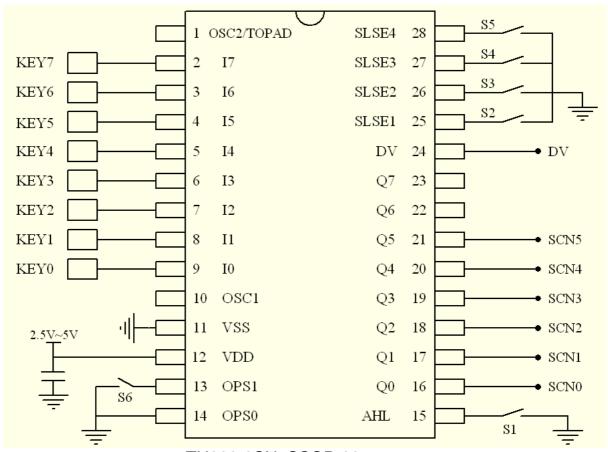


TH288-8SN SSOP-28

- 附: 1. 在PCB上,从<u>触摸点</u>到IC管脚K0到K7的连线长度最好相同。 并且连线不要并行或者与其他线交叉。
 - 2. <u>在应用中如果触摸点较大时</u>,推荐在 IC 管脚 OSC2 与管脚 TOPAD 之间加一电容,电容容量可根据实际应用选取;这样能提高稳定性。 其他应用则将 OSC2 与 TOPAD 短路。(该项在 TH288-4SN 里才用)
 - 3. 供电电源必须稳定。如果电源电压漂移或者快速变化,可能引起灵敏度不正常或者检测错误。

b. 矩阵键模式

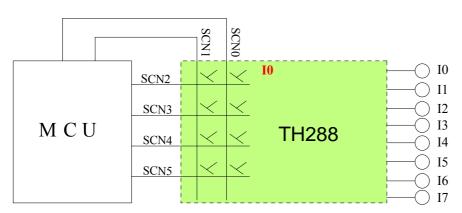
矩阵键输出模式的应用



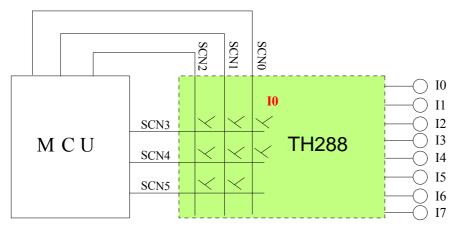
TH288-8SN SSOP-28

- 附: 1. 在PCB上,从<u>触摸点</u>到IC管脚K0到K7的连线长度最好相同。 并且连线不要并行或者与其他线交叉。
 - 2. <u>在应用中如果触摸点较大时</u>,推荐在 IC 管脚 OSC2 与管脚 TOPAD 之间加一电容,电容容量可根据实际应用选取;这样能提高稳定性。 其他应用则将 OSC2 与 TOPAD 短路。(该项在 里才用)
 - 3. 供电电源必须稳定。如果电源电压漂移或者快速变化,可能引起灵敏度不正常或者检测错误。

* Examples of the Matrix 2*4 & 3*3

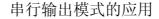


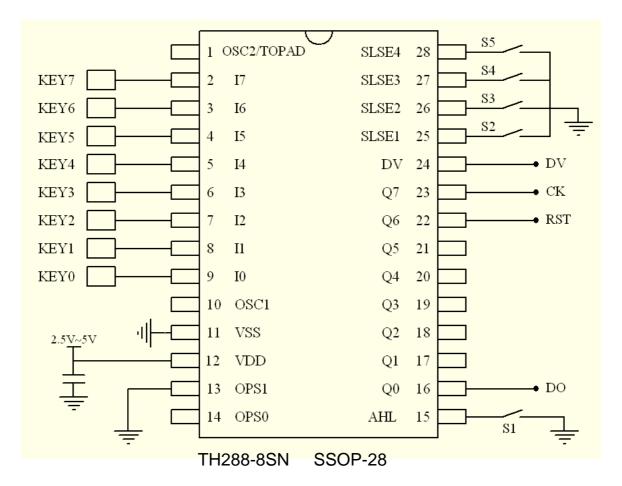
Metrix	SOV2	SONB	SOV#	<i>\$</i> 3\ <i>5</i>
<i>\$</i> 3 \ 0	10	12	4	16
SOVI	11	13	15	17



Matrix	SCN3	SCN4	SCN5
SCN0	10	13	16
SCN1	I1	14	17
SCN2	12	15	-

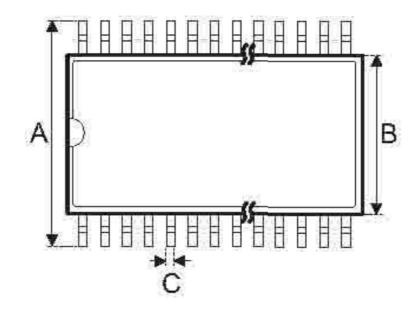
c. 串行输出模式

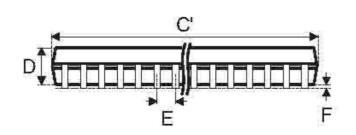


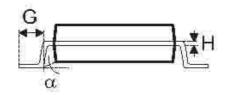


- 附: 1. 在PCB上,从<u>触摸点</u>到IC管脚K0到K7的连线长度最好相同。 并且连线不要并行或者与其他线交叉。
 - 2. <u>在应用中如果触摸点较大时</u>,推荐在 IC 管脚 OSC2 与管脚 TOPAD 之间加一电容,电容容量可根据实际应用选取;这样能提高稳定性。 其他应用则将 OSC2 与 TOPAD 短路。(该项在 里才用)
 - 3. 供电电源必须稳定。如果电源电压漂移或者快速变化,可能引起灵敏度不正常或者检测错误。

封装概要 (28 管脚 SSOP)







SYMBOL	DIMENSION	(Unit: mil)	
SIMBOL	MIN	MAX	
A	228	244	
В	150	157	
С	8	12	
C'	386	394	
D	54	60	
Е	25 typ		
F	4	10	
G	22	28	
Н	7	10	
α	0 °C	8 °C	

FAQ

- 當手按在按鍵時,它的訊號是多久更新一次 當VDD=3V時System clock約為440KHz,大約55Hz更新輸出一次
- 壓克力的最大厚度和最小面積為多少? 要依照靈敏度和 Touch PAD 的大小來決定,其原理是和改變電容容值有關, 電容要看面積和距離來決定.以厚度為 2mm 來作例子,建議 PAD 面積最小為5*5mm
- PAD與PAD的最小間距為多少 4mm(主要是怕大拇指效應,IC是可以辨識到 1mm 以內)
- PAD周圍如果有帶電氣的元件,至少要相距多少才不會影響感應靈敏度 4mm
- PCB的厚度是否有要求? 沒有,但是要和外殼緊密接合
- 壓克力的顏色是否會影響靈敏度 不影響
- 除了壓克力外還有哪種材質可以使用 塑膠,玻璃,木材,皮革,陶瓷,布料 .. 等絕緣材料
- PCB的Lavout有什麼要注意的?
 - (1) PAD到IC的連接線越短越好,線寬使用最小寬度
 - (2) PAD 和 PAD 的走線,不能在 PCB 兩面做交叉
 - (3) PAD 的背面 PCB 不能走線, 走線不能和 PAD 同一面
 - (4) PAD 週邊和後面不要鋪地, 會降低靈敏度, 要鋪地需要距離 PAD 邊 3mm
 - (5) 相鄰 PAD 和 PAD 的走線, 其線和線的距離寬度, 建議:
 - 並行 3cm 要有 1mm 線距
 - 並行 5cm 要有 1.5mm 線距
 - 並行 7cm 要有 2mm 線距
 - 並行 >7cm 線與線之間,要有 GND 線隔離
 - (6) PAD範圍內走線不要有其他的信號線穿過,如果有干擾源,可以在 PAD 範圍 內鋪地來防止干擾源
 - (7) 電源獨立供給TH288 (要加 LDO), 不要與其他元件使用相同電源
 - (8) 要獨立一塊 PCB, 把 IC 和 LDO 做在一起
- 建議把線路圖(原理圖)和 Layout 的 Gerber file Email給我,並告知應用產品和觸摸厚度,可以幫忙 check.